2015年3月 March 2015

文章编号:1004-0609(2015)03-0740-07

# 基片温度对 WO<sub>3</sub> 薄膜的微观结构和 NO<sub>2</sub> 气敏特性的影响



沈岩柏,张宝庆,曹先敏,魏德洲,刘文刚,高淑玲

(东北大学 资源与土木工程学院,沈阳 110819)

摘 要:采用直流反应磁控溅射法,在不同的基片温度条件下制备出具有不同微观结构的 WO<sub>3</sub> 薄膜,探讨这些 薄膜作为气敏材料对 NO<sub>2</sub> 气体的气敏特性。WO<sub>3</sub> 薄膜的晶体结构、表面及断面形貌分别采用 X 射线衍射和扫描 电子显微镜进行表征。结果表明:随着基片温度的升高,具有单斜晶 WO<sub>3</sub> 结构薄膜的(200)衍射峰强度逐渐增强, 薄膜由低基片温度(-75)的纳米粉体、过渡到中间基片温度(-50~300)的纳米薄膜、直至高基片温度(500) 的纳米棒组成。所有 WO<sub>3</sub> 薄膜均在 200 的工作温度下获得对 NO<sub>2</sub> 气体的最大灵敏度。在相同的检测条件下, 气体灵敏度随着基片温度的减小和 NO<sub>2</sub> 气体浓度(体积分数)的增加而增大。 关键词:三氧化钨;薄膜;基片温度;二氧化氮;气体传感器

中图分类号:TN 304.92 文献标志码:A

# Effect of substrate temperature on microstructure and NO<sub>2</sub> sensing properties of WO<sub>3</sub> thin films

SHEN Yan-bai, ZHANG Bao-qing, CAO Xian-min, WEI De-zhou, LIU Wen-gang, GAO Shu-ling

(School of Resources and Civil Engineering, Northeastern University, Shenyang 110819, China)

**Abstract:** WO<sub>3</sub> thin films with various microstructures were deposited at different substrate temperatures using DC reactive magnetron sputtering. NO<sub>2</sub> sensing properties of these WO<sub>3</sub> thin films as the sensing materials were investigated. The crystal structure and morphology of these WO<sub>3</sub> thin films were characterized by X-ray diffractometry and scanning electron microscopy. The results show that, as the substrate temperature increases, the intensity of (200) diffraction peak gradually increases for these films composed of monoclinic WO<sub>3</sub> structure. The morphology changes from nanopowders at a low substrate temperature of -75, to nanofilms at the substrate temperature range of -50-300, finally to nanorods at a high substrate temperature of 500. All the film sensors show the highest NO<sub>2</sub> response at an operating temperature of 200. Under the same conditions, the response increases with the decrease of substrate temperature and the increase of NO<sub>2</sub> concentration (volume fraction).

Key words: tungsten oxide; thin film; substrate temperature; nitrogen dioxide; gas sensor

在矿产资源的勘探及开发利用过程中,产生和排 放的有毒有害气体的种类和数量在不断增加。在这些 气体中,有些是易燃易爆的,有些是有毒有害的,它 们若泄漏到空气中会严重地污染环境,并有引发爆炸、 火灾或使人中毒的潜在危险<sup>[1-2]</sup>。为了有效防治有害气 体的产生、泄漏及污染,对其进行快速、准确、便携的检测非常必要。因此,开发高性能的气体传感器势 在必行,不仅可以有效地避免潜在安全事故的发生, 同时还为后续的有害气体处理提供了可靠的前期监测 保障。

基金项目:国家优秀青年科学基金资助项目(51422402);中央高校基本科研业务费资助项目(N120501002);辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助 项目(LJQ2013025);教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题(20130042120033);教育部留学回国人员科研启动基金 资助项目(47-3)

收稿日期:2014-07-21;修订日期:2014-11-15

通信作者:沈岩柏,教授,博士;电话:024-83692711;E-mail:shenyanbai@mail.neu.edu.cn

在种类众多的气体传感器中,从气敏材料的应用 范围、普及程度以及实用性来看,半导体气体传感器, 特别是电阻型半导体气体传感器,已成为世界上产量 最大、应用最广的气体传感器之一,其检测原理是利 用被检测气体与半导体表面化学吸附氧的相互作用而 引起半导体电阻的变化来检测气体或测量气体的浓 度<sup>[3]</sup>。因而,半导体材料的比表面积是决定化学吸附 氧数量和气体灵敏度的最主要因素之一。WO3是一种 n 型半导体材料,禁带宽度在 2.5~3.5 eV,具有优异的 气敏、光电和催化等特性,因而在气体传感器、显示 器、光催化和电极材料等方面均有广泛的用途<sup>[4-8]</sup>。目 前,制备 WO3薄膜的方法主要有溅射法、溶胶-凝胶 法、热蒸发法、化学气相沉积法和脉冲激光刻蚀沉积 法等<sup>[9-13]</sup>, 而溅射法由于成膜纯度高、致密性和均匀 性好、沉积速度快和重现性好等优点,已经显示出优 异的制备薄膜的能力。依据 THORNTON<sup>[14]</sup>提出的溅 射薄膜模型,多孔化薄膜可以在低基片温度和高溅射 压强下所获得,然而目前可控的最低基片温度为室温, 在零下温度范围内来制备溅射薄膜还未见报道。本文 作者采用磁控溅射法在不同基片温度下于氧化硅基片 表面制备出具有不同形貌的 WO3 薄膜,通过液氮冷却 以获得零下基片温度和加入加热电阻以获得高基片温 度。采用 XRD 和 SEM 来表征 WO3薄膜的相组成和 微观形貌,以 WO3 薄膜作为气敏材料制备成气敏元 件,考察其对 NO2 气体的气敏特性。

## 1 实验

1.1 薄膜样品的制备

采用如图 1 所示的直流反应磁控溅射系统在表面 覆有厚度为100 nm氧化层的硅基片上沉积 WO3薄膜, 所用靶材为钨靶, 纯度为 99.99%, 直径为 100 mm。 基片在薄膜沉积之前分别用中性清洗剂、丙酮和去离 子水在超声清洗机内清洗,然后立即用吹风机热风吹 干。实验本底真空为 4×10<sup>-4</sup> Pa, 溅射过程中充入氩 气作为工作气体,氧气作为反应气体,溅射气压固定 为 12 Pa, 氩气和氧气的流量分别采用两个质量流量控 制器来调节,并按体积比1:1充入溅射腔内,溅射功 率为 100 W。在沉积薄膜前,用遮板挡住基片进行预 溅射 5 min,目的是清除钨靶材表面的污染物。基片 温度通过放置在基片附近的热电偶来控制,通过向基 片底部的温控室中添加液氮(沸点为-196 )以获得 零下基片温度,通过放入加热电阻以获得高基片温度, 从而获得-75、-50、25、300 和 500 的基片温度。

制备气敏元件时,首先通过溅射法在洁净的硅基片表 面制作铂金叉指电极,然后在电极上沉积 WO<sub>3</sub>薄膜。 在沉积薄膜 2 h 后,将薄膜在空气中于 600 温度下 进行 4 h 的热处理,以保证薄膜结构和气敏特性的稳 定。

WO<sub>3</sub> 薄膜的晶体结构采用 X'Pert Pro 型 X 射线衍 射仪(Cu K<sub>a</sub>,  $\lambda$ =1.5406 Å)进行测定,管电压为 40 kV, 管电流为 40 mA,扫描范围为 20°~60°;薄膜的表面 及断面形貌采用 Ultra Plus 型扫描电子显微镜来观察, 加速电压为 20 kV。

#### 1.2 气敏特性测定

气敏特性的测定装置主要由配气系统、加热系统 及检测系统 3 个部分组成。配气系统通过质量流量控 制计来调节 NO<sub>2</sub>和干燥空气的体积及流量,以获得浓 度为 1×10<sup>-7</sup>~3×10<sup>-6</sup>(体积分数)的 NO<sub>2</sub>气体,混合气 体总流量固定在 200 mL/min。加热系统通过管式炉对 气敏元件进行温度控制,调节工作温度在 50~300 范围内。检测系统是将气敏元件放置在配有石英管的 管式电炉中,连接好电路后,采用伏安法由 Agilent 34972A 数据采集器记录气敏元件在干燥空气和一定 浓度 NO<sub>2</sub> 气体下的电阻变化。在本研究中,WO<sub>3</sub> 薄膜 对 NO<sub>2</sub> 气体的灵敏度(*S*)定义为

 $S = (R_{\rm g} - R_{\rm a})/R_{\rm a} \tag{1}$ 

式中: $R_a$ 和  $R_g$ 分别为 WO<sub>3</sub>薄膜在干燥空气和一定浓度 NO<sub>2</sub>气体下的电阻值。



图1 直流反应磁控溅射系统示意图

**Fig. 1** Schematic diagram of DC reactive magnetron sputtering apparatus

# 2 结果与讨论

#### 2.1 形貌与结构

不同基片温度下沉积的 WO<sub>3</sub> 薄膜的 SEM 像如图 2 所示。由图 2 可知,基片温度对 WO<sub>3</sub> 薄膜的形貌具



图 2 不同基片温度下沉积的  $WO_3$  薄膜的表面及断面 SEM 像

Fig. 2 Surface and cross-sectional SEM images of WO3 thin films deposited at different substrate temperatures

有明显的影响。在基片温度为-75 时,WO<sub>3</sub>薄膜主 要由絮状的纳米粉体颗粒组成,颗粒的平均直径约为 100 nm,并呈现团簇现象;基片温度在-50~300 范 围内,WO<sub>3</sub>薄膜的成膜性好且表面较为平滑。薄膜主 要由柱状颗粒所组成,随着基片温度的升高,薄膜逐 渐变得致密,孔隙率呈下降趋势;在基片温度为 500 时,WO<sub>3</sub>薄膜则由结晶状况优良的纳米棒所组 成,纳米棒的平均直径约为150 nm,长度约为1 μm。

磁控溅射镀膜的基本原理是在真空中利用Ar-O<sub>2</sub> 混合气体中的等离子体在电场和交变磁场的作用下, 通过加速的高能粒子轰击靶材表面,能量交换后实现 靶材表面的原子脱离原晶格而逸出,与氧气反应后从 而转移到基片表面而成膜的过程<sup>[15]</sup>。在较高的溅射气 压(12 Pa)条件下,一方面真空腔内的氩气分子增多, 溅射粒子与氩气分子的碰撞次数增加,导致溅射粒子 在碰撞过程中损失大量的能量,致使到达基片的数量 较少;另一方面,氩气分子的平均自由程减小,溅射 粒子与真空腔内气体分子的碰撞几率增大,使得到达 基片的溅射粒子能量较低。在基片温度为-75 时, 这些具有低能量的WO<sub>3</sub>粒子在基片表面的迁移能力 较差,因此,沉积的薄膜较为疏松,从而形成絮状的 纳米粉体颗粒;在基片温度-50~300 范围时,沉积 在基片表面的WO3粒子的能量逐渐增强,同时在基片 表面的迁移能力也显著增大,因而薄膜变得更加平滑 且致密;而当基片温度为500 时,沉积在基片表面 的WO3粒子能量最高,迁移能力也最强,因此更容易 从基片上逃逸出来而重新回到真空腔内,导致这些粒 子沿某一维方向结晶生长,形成纳米棒。

图 3 所示为不同基片温度下沉积的 WO<sub>3</sub> 薄膜的 XRD 谱。从图 3 可以看出,虽然 5 个薄膜的晶体取向



图 3 不同基片温度下沉积的 WO<sub>3</sub> 薄膜的 XRD 谱 Fig. 3 XRD patterns of WO<sub>3</sub> thin films deposited at different substrate temperatures: (a) -75; (b) -50; (c) 25; (d) 300; (e) 500

稍有不同,但每个 XRD 谱均表明单斜晶 WO<sub>3</sub>结构的 形成,衍射峰位与标准卡片 JCPDS 43–1035 相一致。 随着基片温度的升高,位于衍射角 24.38°处的(200)衍 射峰的强度逐渐增强,表明 WO<sub>3</sub>薄膜样品的结晶度越 来越好。特别是当基片温度为 500 时,薄膜的结晶 状况非常好,其中的三强峰(002)、(020)和(200)的强度 急剧增强,并且沿(200)晶面择优取向生长。

WO<sub>3</sub> 薄膜的平均晶粒尺寸可由 Scherrer 公式  $D=k\lambda/(\beta\cos\theta)$ 计算得到。其中, D 为平均晶粒尺寸; k 为常数(k=0.89);  $\lambda$  为入射 X 射线波长( $\lambda=0.15406$  nm);  $\beta$  为衍射峰的半高峰宽(rad);  $\theta$  为衍射角(°)。从 XRD 谱中可以看出, WO<sub>3</sub> 薄膜的最强衍射峰为(200), 表明 其为最主要的生长择优取向,故选取该晶面的衍射峰 来计算平均晶粒尺寸,结果如图 4 所示。从图 4 可以 看出,薄膜的晶粒尺寸随着基片温度的升高而增大, 从基片温度-75 的 12 nm 逐渐增大到基片温度 500 的 42 nm。这个晶粒尺寸增大的趋势是由于基 片温度逐渐升高后,溅射粒子的能量和迁移能力也逐 渐增加,更加有助于晶粒的生长,从而导致晶粒尺寸 增大。



图 4 WO3 薄膜的平均晶粒尺寸与基片温度的关系



#### 2.2 气敏特性

典型的气体灵敏度与工作温度之间的关系如图 5 所示,其中 WO<sub>3</sub>薄膜沉积时的基片温度为 25 ,NO<sub>2</sub> 气体浓度为 3 × 10<sup>-6</sup>。从图 5 中可以看出,气体灵敏度 随着工作温度的升高而逐渐增大,并在 200 的工作 温度下获得对 NO<sub>2</sub>气体的最大灵敏度 43.3;随着工作 温度继续升高,气体灵敏度开始下降,这是由于薄膜 的气敏特性不仅与薄膜材料本身有关,还与 NO<sub>2</sub>气体 与薄膜材料的表面吸附/解吸有很大的关系<sup>[16-17]</sup>。在工 作温度较低时,WO<sub>3</sub>薄膜表面的化学吸附氧较少,而 且活性较低,导致其与 NO<sub>2</sub>气体的吸附作用较弱,因 而气体灵敏度较低;当工作温度过高时,在WO3薄膜



图 5 基片温度为 25 时沉积的 WO<sub>3</sub> 薄膜对 3 × 10<sup>-6</sup> NO<sub>2</sub> 气体的灵敏度与工作温度的关系

Fig. 5 Relationship between response of WO<sub>3</sub> thin film deposited at substrate temperature of 25 to  $3 \times 10^{-6}$  NO<sub>2</sub> gas and operating temperature

表面发生的气敏反应速度过快,限制了 NO<sub>2</sub> 气体的扩散,使得薄膜表面被吸附的 NO<sub>2</sub> 气体浓度较小,同样 会引起气体灵敏度的降低,因此会出现一个获得最大 气体灵敏度的工作温度。应该指出的是,虽然未显示 出其他基片温度下沉积的 WO<sub>3</sub> 薄膜的气体灵敏度与 工作温度之间的关系,但是所有薄膜均在 200 的工 作温度下获得对 NO<sub>2</sub> 气体的最大灵敏度。

图 6 所示为不同基片温度下沉积的 WO<sub>3</sub> 薄膜在 200 的工作温度下对  $3 \times 10^{-6}$  NO<sub>2</sub> 气体的动态响应 恢复曲线(时间负值表示未通入 NO<sub>2</sub> 气体前的时间)。 当通入 NO<sub>2</sub> 气体后,WO<sub>3</sub> 薄膜的电阻迅速增大,当响 应时间为 60 s 左右,即可达到电阻稳定状态;当 NO<sub>2</sub> 气体排出后,WO<sub>3</sub> 薄膜的电阻逐渐降低,直至恢复到 电阻初始值,恢复时间相对较长,整个响应恢复过程 具有可逆性。产生相对较长的恢复时间,一方面是由 于 NO<sub>2</sub> 从 WO<sub>3</sub> 气敏材料中进行解吸时需要穿过薄膜



内的多孔化结构,这个扩散过程需要一定的时间;另 一方面是由于 WO<sub>3</sub> 薄膜底部已经被解吸下来的 NO<sub>2</sub> 有可能会与上层的 WO<sub>3</sub> 进行再吸附,从而导致恢复时 间的延长。此外,随着基片温度从-75 到 500 逐 渐升高,通入 NO<sub>2</sub> 气体后的薄膜电阻变化逐渐减小, 表明气体灵敏度呈现下降趋势,这主要是由于氧化物 半导体对被检测气体的响应-恢复是一个复杂的物理 化学过程,包括表面吸附/解吸、氧在微晶间的扩散、 气体在孔间的扩散等,表明气体的响应-恢复特性与 薄膜的微观结构密切相关<sup>[18-19]</sup>。

WO<sub>3</sub>薄膜在 200 工作温度下对 3 × 10<sup>-6</sup> NO<sub>2</sub> 气体的灵敏度与基片温度之间的关系如图 7 所示。从图 7 中可以看出,随着基片温度的升高,气体灵敏度明显下降。在基片温度为-75、-50、25、300 和 500时,气体灵敏度分别为 424.5、146.3、43.3、22.7 和 6.0。由图 4 所示的研究结果可知,薄膜的晶粒尺寸随



图 6 不同基片温度下沉积的 WO<sub>3</sub> 薄膜在 200 工作温度下对 3 × 10<sup>-6</sup> NO<sub>2</sub> 气体的动态响 应恢复曲线

**Fig. 6** Response recovery curves of WO<sub>3</sub> thin films deposited at different substrate temperatures to  $3 \times 10^{-6}$  NO<sub>2</sub> gas at operating temperature of 200 : (a) -75 ; (b) -50 ; (c) 25 ; (d) 300 ; (e) 500

着基片温度的下降而减小,而晶粒尺寸的大小直接决 定薄膜的比表面积和表面活性<sup>[20]</sup>。由尺寸较小的晶粒 所构成的薄膜具有较大的比表面积和表面活性,可以 提供更大的吸附面积参与气敏反应,因而气体灵敏度 较高;而尺寸较大的晶粒所构成的薄膜的情况与之相 反,导致气体灵敏度较低。

为了进一步探讨 WO<sub>3</sub> 薄膜的气敏特性,还考察了 WO<sub>3</sub> 薄膜在 200 的工作温度下对不同浓度 NO<sub>2</sub> 气 体的灵敏度,结果如图 8 所示。对于任意 WO<sub>3</sub> 薄膜, 随着 NO<sub>2</sub> 气体浓度的增加,气体灵敏度逐渐增大。当 NO<sub>2</sub> 气体浓度从  $1 \times 10^{-7}$ 增加到  $1 \times 10^{-6}$ 时,气体灵敏 度变化明显;而当 NO<sub>2</sub> 气体浓度从  $1 \times 10^{-6}$ 增加到  $3 \times 10^{-6}$ 时,气体灵敏度逐渐趋近稳定。以基片温度 -75 的薄膜为例,其对  $1 \times 10^{-7}$ 、 $1 \times 10^{-6}$ 和  $3 \times 10^{-6}$ 的 NO<sub>2</sub> 气体的灵敏度分别为 4.1、229.1 和 424.5。



图 7  $WO_3$  薄膜在 200 工作温度下对  $3 \times 10^{-6} NO_2$  气体的 灵敏度与基片温度之间的关系

Fig. 7 Relationship between response of WO<sub>3</sub> thin films to  $3 \times 10^{-6}$  NO<sub>2</sub> gas and substrate temperature at operating temperature of 200



气体浓度的关系

**Fig. 8** Relationship between response of WO<sub>3</sub> thin films and NO<sub>2</sub> gas concentration at operating temperature of 200

图 9 所示为基片温度为 500 下沉积的 WO<sub>3</sub> 薄 膜在 200 工作温度下对不同浓度 NO<sub>2</sub> 气体的动态 响应-恢复曲线。当任意浓度的 NO<sub>2</sub> 气体被排出后, WO<sub>3</sub> 薄膜的电阻均可恢复至初始值,表明 WO<sub>3</sub> 薄膜 具有优越的稳定性和重现性。此外,还应该指出的是, 在其他基片温度条件下沉积的 WO<sub>3</sub> 薄膜对不同浓度 NO<sub>2</sub> 气体同样具有良好的动态响应恢复特性。



图 9 基片温度为 500 下沉积的 WO<sub>3</sub> 薄膜在 200 工作 温度下对不同浓度 NO<sub>2</sub> 气体的动态响应恢复曲线 **Fig. 9** Response recovery curves of WO<sub>3</sub> thin film deposited at substrate temperatures of 500 to NO<sub>2</sub> gas with different concentrations at operating temperature of 200

## 3 结论

1) 采用直流反应磁控溅射法,在不同基片温度条件下制备出具有不同微观结构的 WO<sub>3</sub> 薄膜。随着基片 温度的增加,具有单斜晶 WO<sub>3</sub> 结构的薄膜的形貌由低 基片温度(-75)的纳米粉体过渡到中间基片温度 (-50~300)的纳米薄膜,直至高基片温度(500) 的纳米棒。

2) WO<sub>3</sub> 薄膜的晶粒尺寸随着基片温度的升高而 增大,从基片温度-75 的 12 nm 逐渐增大到基片温 度 500 的 42 nm,其晶粒尺寸增大的原因主要是基 片温度逐渐升高后,溅射粒子的能量和迁移能力也逐 渐增加,更加有助于晶粒的生长。

3) WO<sub>3</sub> 薄膜的气敏特性研究结果表明,所有 WO<sub>3</sub> 薄膜均在 200 的工作温度下获得对 NO<sub>2</sub> 气体的最 大灵敏度。在相同的检测条件下,气体灵敏度随着基 片温度的减小和 NO<sub>2</sub> 气体浓度的增加而逐渐增大。

#### REFERENCES

- [1] BARRECA D, BEKERMANN D, COMINI E, DEVI A, FISCHER R A, GASPAROTTO A, MACCATO C, SBERVEGLIERI G, TONDELLO E.1D ZnO nano-assemblies by plasma-CVD as chemical sensors for flammable and toxic gases[J]. Sensors and Actuators B, 2010, 149(1): 1–7.
- [2] 郭斯淦,郑顺旋,谢 格. SnO<sub>2</sub>:ZnO薄膜的气敏透射光谱研 究[J]. 光谱学与光谱分析, 1992, 12(6): 19-23.
   GUO Si-gan, ZHENG Shun-xuan, XIE Ge. Study of the gas sensing transmission spectrum for SnO<sub>2</sub>:ZnO film[J].
   Spectroscopy and Spectral Analysis, 1992, 12(6): 19-23.
- [3] 王红勤,杨修春,蒋丹宇. 电阻型半导体气体传感器的概况

#### 第25卷第3期

[J]. 陶瓷学报, 2011, 32(4): 602-609.

WANG Hong-qin, YANG Xiu-chun, JIANG Dan-yu. The development overview of gas sensors of electric resistance semiconductor[J]. Journal of Ceramics, 2011, 32(4): 602–609.

- [4] SHEN Y B, ZHANG B Q, CAO X M, WEI D Z, MA J W, JIA L J, GAO S L, CUI B Y, JIN Y C. Microstructure and enhanced H<sub>2</sub>S sensing properties of Pt-loaded WO<sub>3</sub> thin films[J]. Sensors and Actuators B, 2014, 193(1): 273–279.
- [5] SHEN Y B, YAMAZAKI T, LIU Z F, MENG D, KIKUTA T, NAKATANI N. Influence of effective surface area on gas sensing properties of WO<sub>3</sub> sputtered thin films[J]. Thin Solid Films, 2009, 517(1): 2069–2072.
- [6] 陈 香,李 洁,李文章,陈启元. 纳米多孔 WO<sub>3</sub> 薄膜电极的制备及其光电化学性质[J]. 中国有色金属学报, 2012, 22(12): 3487-3494.
   CHEN Xiang, LI Jie, LI Wen-zhang, CHEN Qi-yuan.

Preparation and photo electrochemical properties of nano-porous tungsten trioxide films electrode[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2012, 22(12): 3487–3494.

- [7] HO G W, CHUA K J, SIOW D R. Metal loaded WO<sub>3</sub> particles for comparative studies of photocatalysis and electrolysis solar hydrogen production[J]. Chemical Engineering Journal, 2012, 181/182(1): 661–666.
- [8] MARTÍN A J, CHAPARRO A M, DAZA L. Single cell study of electrodeposited cathodic electrodes based on Pt-WO<sub>3</sub> for polymer electrolyte fuel cells[J]. Journal of Power Sources, 2011, 196(9): 4187–4192.
- [9] CHARLES C, MARTIN N, DEVEL M, OLLITRAULT J, BILLARD A. Correlation between structural and optical properties of WO<sub>3</sub> thin films sputter deposited by glancing angle deposition[J]. Thin Solid Films, 2013, 534(1): 275–281.
- [10] 李文章,李 洁,王 旋,黄 晔,陈启元.不同衬底上纳米 晶 WO<sub>3</sub> 薄膜的光致发光特性[J].中国有色金属学报, 2011, 21(5): 1080-1086.
  LI Wen-zhang, LI Jie, WANG Xuan, HUANG Ye, CHEN Qi-yuan. Photoluminescence of nano-structured WO<sub>3</sub> films on different substrates[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2011, 21(5): 1080-1086.
- [11] SINGLA G, SINGH K, PANDEY O P. Structural and thermal properties of in-situ reduced WO<sub>3</sub> to W powder[J]. Powder Technology, 2013, 237(1): 9–13.

- [12] TESFAMICHAEL T, PONZONI A, AHSAN M, FAGLIA G. Gas sensing characteristics of Fe-doped tungsten oxide thin films[J]. Sensors and Actuators B, 2012, 168(1): 345–353.
- [13] ZOU Y S, ZHANG Y C, LOU D, WANG H P, GU L, DONG Y H, DOU K, SONG X F, ZENG H B. Structural and optical properties of WO<sub>3</sub> films deposited by pulsed laser deposition[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2014, 583(1): 465–470.
- [14] THORNTON J A. The microstructure of sputter-deposited coatings[J]. Journal of Vacuum Science & Technology A, 1986, 4(6): 3059–3065.
- [15] 李 明, 宓一鸣, 言 智, 季 鑫. 薄膜材料的制备与表征方法研究进展[J]. 上海工程技术大学学报, 2012, 26(2): 125-128, 132.
  LI Ming, MI Yi-ming, YAN Zhi, JI Xin. Research progress of preparation and characterization of thin film materials[J]. Journal

preparation and characterization of thin film materials[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2012, 26(2): 125–128, 132.

- [16] CANTALINI C, SUN H T, FACCIO M, PELINO M, SANTUCCI S, LOZZI L, PASSACANTANDO M. NO<sub>2</sub> sensitivity of WO<sub>3</sub> thin film obtained by high vacuum thermal evaporation[J]. Sensors and Actuators B, 1996, 31(1): 81–87.
- [17] 尹英哲,胡 明,冯有才,陈 鹏. 直流反应磁控溅射 WO<sub>3</sub> 薄膜气敏特性研究[J]. 传感技术学报, 2007, 20(4): 760-762. YIN Ying-zhe, HU Ming, FENG You-cai, CHEN Peng. Study on gas sensing-characteristics of WO<sub>3</sub> thin film manufactured by dc reactive magnetron sputtering[J]. Chinese Journal of Sensors and Actuators, 2007, 20(4): 760-762.
- [18] KOROTCENKOV G. Gas response control through structural and chemical modification of metal oxide films: State of the art and approaches[J]. Sensors and Actuators B, 2005, 107(1): 209–232.
- [19] LIU Z F, YAMAZAKI T, SHEN Y B, KIKUTA T, NAKATANI N. Influence of annealing on microstructure and NO<sub>2</sub>-sensing properties of sputtered WO<sub>3</sub> thin films[J]. Sensors and Actuators B, 2007, 128(1): 173–178.
- [20] ZENG J, HU M, WANG W D, CHEN H Q, QIN Y X. NO<sub>2</sub>-sensing properties of porous WO<sub>3</sub> gas sensor based on anodized sputtered tungsten thin film[J]. Sensors and Actuators B, 2012, 161(1): 447–452.

(编辑 龙怀中)